

装置/手法:

ミクロトーム、ウルトラミクロトームによる断面加工



<概要>

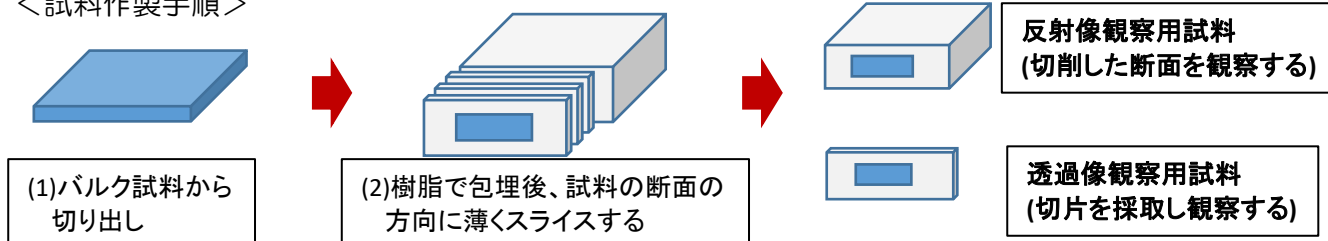
試料を樹脂等で固定し、ナイフにより切り出すことで、試料の断面を観察できるように加工を行います。

ウルトラミクロトームでは、さらに-100℃まで冷却しての切削や、断面透過像用に約100nmの超薄切片の作製も可能です。

加工した試料は光学顕微鏡や電子顕微鏡にて観察を行います。

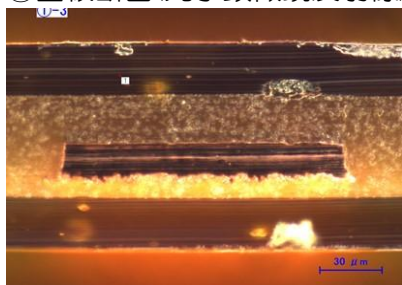
※ガラス繊維や無機鉱物、硬い金属を多く含む試料はナイフによる切削がうまくできませんので別の方法をご案内させていただきます。

<試料作製手順>

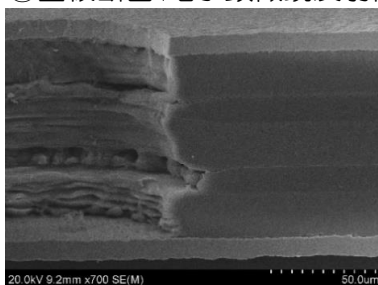


<分析例>

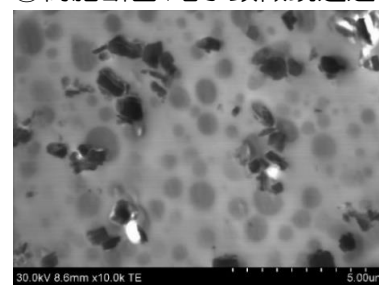
①基板断面(光学顕微鏡反射像)



②基板断面(電子顕微鏡反射像)



③樹脂断面(電子顕微鏡透過像)



標準料金: 1試料、1加工当たり 8,000円(税別)~
※目的や試料のサイズなどによって、変動しますので、お問合せ下さい。



株式会社 有沢製作所

分析センター

〒943-8610 新潟県上越市大字中田原1番地
TEL: 025-524-2400 FAX: 025-524-5281
URL: <http://www.arisawa.co.jp>
E-mail: bunseki@arisawa.co.jp